

EINZIGARTIGE LÖSUNG FÜR DIE ELEKTRONIK PRODUKTION

Lotpasten Jetten, Kleber Jetten und Bestückung





archerfish.

EINZIGARTIGE LÖSUNG FÜR DIE ELEKTRONIK PRODUKTION

Lotpasten Jetten, Kleber Jetten, Bestückung und weitere Prozesslösungen auf einer einzigen Plattform.

kombiniertes all-in-one.

- Bestückung, Lotpasten & weitere Jet-Dosierprozesse
- Bis zu 4 Bestückachsen und 3 Dosierprozesse

prozess kontrolle.

- Kontrolle von Grösse, Vol. & Gewicht der Punkte
- Prozesssteuerung und Punktstabilisierung

höchste flexibilität.

- Verbesserung Ihrer Time to Market/ NPI / Reparatur
- Keine Schablonen, Anpassung der Prozessvariation
- Jetten in Kavitäten, Pin in paste jetten
- Freie LP Gestaltung - frei programmierbar
- 2.5D Bestück- und Dosieranwendungen

software für alle prozesse.

- Gerber Datei Umwandlung und CAD Datenimport
- Generator für Produktionsdateien mit einem Klick
- Echtzeit Visualisierung
- Konnektivität SECS/GEM, iTac, OIC, Hermes



kostenoptimierung.

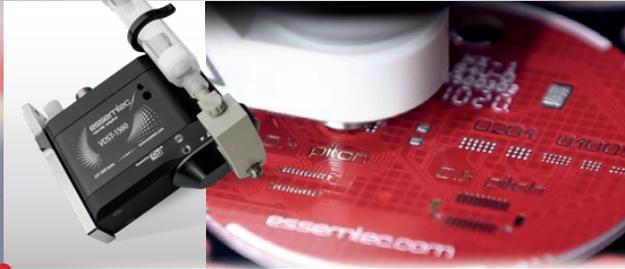
- Eine platzsparende Plattform für alle Prozesse
- Kostensenkung (kein extra Drucker o. Schablonen)
- Kein Zeitverlust beim Umrüsten

**KOMPATIBEL MIT ALLEN
AKTUELLEN ESSEMTEC
PLATTFORMEN**

naturally adaptive.

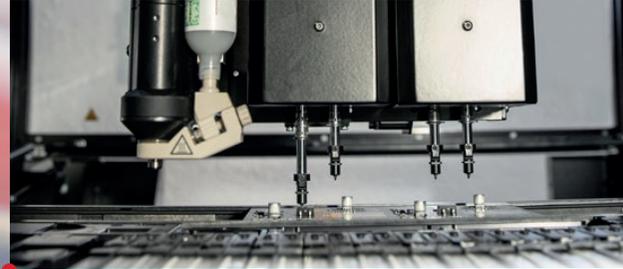


ERWEITERBAR IN JEDE RICHTUNG.
EINSETZBAR VOM PROTOTYP BIS
ZUR HIGH SPEED PRODUKTION.



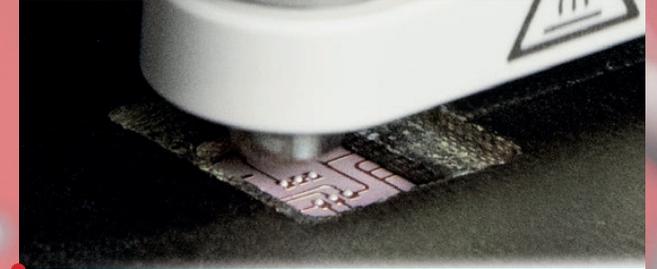
lotpasten jet printing

Dynamic Shockwave Technologie. Anpassbar für verschiedene jetbare Pasten (T4-7). Anpassbar für spezielle Anwendungen (Düse, Stößel, Temperatur etc.). Nadeln für Jetten in Kavitäten. Superschnelle Plug-n-Play-Änderung von Fluidik & Einstellungen.



bestückung

Die Systeme wachsen synchron mit den Anforderungen des Kunden an Leistung und Prozesse. Konfigurierbare Köpfe mit 1-4 Bestückungsachsen. Multiflexibles Feeder-Konzept für bis zu 280 Spuren. Grösstes Bauteilspektrum; 008004 bis 80 x 80 mm.



weitere dosierlösungen

Grosser Anwendungsbereich, wie z.B. SMT Kleber, LED Verkapselung, Silber Epoxidharz, Dämmen und Füllen, Unterfüllen, 2.5D Dosieren & mehr. Prozessparameter können frei geändert und für jeden bestimmten Prozess optimiert werden.



Prozesskontrolle gemäss Automobilindustriestandard, Volle Rückverfolgbarkeit, Integration & Datenübernahme von bestehenden Systemen wie Diplan, UniCam, Cogiscan etc., Reinigungsstation, Hochpräzisionswaage, Heiz- & Vakuumsysteme

Medium Temperierung	Nadel- und Jet Heizsystem
Höhenerkennung	Automatische Höhenerkennung der Dosierfläche
Integrated Inspection	2D Fehlererkennung für Dispensen & Bestückung
Extra grosse LP's	Tischerweiterung, um die Grösse der LP zu erhöhen



Kleber Jet Ventil



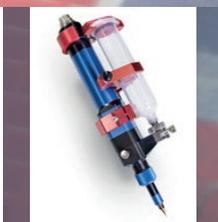
Lotpasten Jet Ventil



Zeit-Druck Ventil



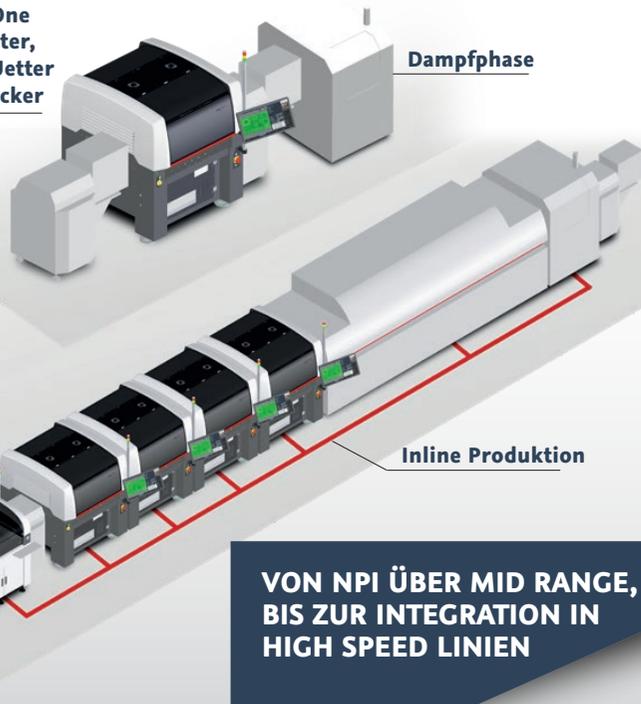
Schrauben Ventil



Volumen Ventil



**All-In-One
Jet Printer,
Kleber Jetter
& Bestücker**



Dampfphase

Inline Produktion

**VON NPI ÜBER MID RANGE,
BIS ZUR INTEGRATION IN
HIGH SPEED LINIEN**

bestückung.	puma ² (bis zu 2 Ventile)	puma ¹ (bis zu 1 Ventil)	fox ² (bis zu 1 Ventil)
Optimale Geschwindigkeit	11'200 BE/h (2-Achsen)	18'100 BE/h (4-Achsen)	12'000 BE/h (2-Achsen)
Feeder Kapazität 8 mm tape	260 (140 inline)	280 (160 inline)	180 (120 inline)
Komponenten Grössen	008004 (imp.) - 80 x 80 mm (Beachten Sie die Specs für Details)		
Bestückgenauigkeit (x, y)	Chip ± 40 µm (3σ) / QFP ± 30 µm (3σ)		
Max. LP Grösse	560 x 610 / 1'800 x 610 mm	560 x 610 / 1'800 x 610 mm	406 x 305 mm
Maschinenstandfläche	1'557 x 1'357 mm	1'557 x 1'357 mm	880 x 1'090 mm

lotpasten jetten.

Viskosität	< 2'000'000 mPa*s
Min. Punkt Ø / Volumen	> 200 µm / > 2.5 nl
Optimale Geschwindigkeit	Ventil 720'000 Punkte/h
Mögliche Lotpasten	Typ 4-7 (jetbar)
Ventil Heizung	Inklusive, max. 60°C
Verwendbare Kartuschen	5 ccm / 10 ccm / 30 ccm

dispensen.

Optimale Geschwindigkeit (Punkte/h)	Kleber Jet: > 720'000 Zeit-Druck: 28'000 Volumen: 24'000 Schraube: 24'000
Dosiermodus	Punkt, Linie, Kurve, interpolierte 2.5D Kontur
Genauigkeit XY Punkte	40 µm (3σ)



**SMARTE HOCHFLEXIBLE
SMT LÖSUNGEN**

Die Tier- und Pflanzenwelt zeigt uns immer wieder, mit welcher atemberaubenden Anpassungsfähigkeit die Natur sich auf verschiedenste Anforderungen der Umwelt einstellen kann. Das inspiriert uns! Die Essemtec AG ist ein Unternehmen mit Entwicklungs- und Produktionsstandort in der Schweiz. Unsere High-Tech Lösungen lassen sich unkompliziert und schnell an unterschiedlichste Rahmenbedingungen anpassen und können so Kundenanforderungen aus verschiedensten Bereichen erfüllen. Deshalb ist „naturally adaptiv“ unser Motto in allen Bereichen.

Haftungsausschluss & Copyright:

Die Informationen in dieser Broschüre dienen zur allgemeinen Information. Für mehr Details lesen Sie bitte die Spezifikationen. Hier gezeigtes Material unterliegt dem Copyright © Essemtec AG, Schweiz, Januar 2024.

Schweiz Essemtec AG

Mosenstrasse 20
CH-6287 Aesch/LU
Tel: +41 41 919 60 60
essemtec.info@nano-di.com

Deutschland Essemtec GmbH

Tanusstrasse 21
DE-80807 München
Tel: +49 893 803 55 15
essemtec.info@nano-di.com

Frankreich Essemtec SAS

50, Avenue d'Alsace
FR-68000 Colmar
Tel: +33 640 658 406
essemtec.info@nano-di.com

Amerika Essemtec USA LLC

300 5th Ave
Waltham, MA 02451
Tel: +1 856 218 11 31
essemtec.sales-usa@nano-di.com

